

2026 年 8 月 27 日

報道関係各位

PALTEK SOLUTION SUPPLIER
PALTEK
プレスリリース
株式会社 PALTEK

**PALTEK が「国際物流総合展 2026」で
Ranpak 紙梱包資材と自律走行ロボットを展示
～紙とロボットが物流現場を変えていく～**

株式会社 PALTEK（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田 光治、以下 PALTEK）は、2026 年 9 月 8 日（火）から 9 月 11 日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展 2026」に出展します。

PALTEK は「紙とロボットが物流現場を変えていく」をテーマに、環境対応や人手不足といった物流業界の課題解決に向けたソリューションを提案します。会場では、Ranpak 株式会社（以下 Ranpak）の環境配慮型紙梱包資材と、ソフトバンクロボティクス株式会社（以下、ソフトバンクロボティクス）が取り扱う工場・倉庫向け自律走行搬送ロボット（AMR：Autonomous Mobile Robot）を展示し、脱プラスチックの推進と物流現場の省人化・効率化を実現する取り組みを紹介します。



展示会出展ブースイメージ

PALTEK が提供する Ranpak の紙梱包資材は、100%再生可能・リサイクル可能・生分解性を特長とし、プラスチック製梱包資材の代替として活用できます。高い緩衝性能と梱包工程の最適化により、梱包資材コストの低減や作業効率化、GHG（温室効果ガス）排出量削減など、環境負荷低減とトータルコスト削減の両立に貢献します。

また、ソフトバンクロボティクスが取り扱う自律走行ロボットは、搬送や清掃など物流・製造現場におけるさまざまな業務の自動化を実現します。PALTEK は、お客様の現場環境や運用課題に合わせたロボット導入・運用提案を通じて、人手不足の解消と業務効率化を支援します。

■展示会の概要

展示会名 : 「国際物流総合展 2026」



開催日時 : 2026年9月8日（火）～11日（金）
10:00～17:00

会場 : 東京ビッグサイト（東京国際展示場）東1～3、7・8ホール、西1～4ホール
（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

PALTEKブースは、W3-C19

主催 : 一般社団法人 日本産業機械工業会
一般社団法人 日本産業車両協会
一般社団法人 日本パレット協会
一般社団法人 日本運搬車両機器協会
一般社団法人 日本物流システム機器協会
公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会
一般社団法人 日本能率協会

展示会URL : <https://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/ltt/>

事前登録URL : <https://www.logistech-online.com/jp/registration.php?exhibitor=EX000356>

■主な出展内容

・次世代緩衝材システム : PadPak Guardian®

「PadPak Guardian®」は、梱包速度の向上によるコスト削減に加え、C字型に折り置まれたペーパーを採用したことにより、緩衝材の補充作業など使い勝手のよい操作性を提供します。

これにより、電子・電気部品から自動車用スเปアパーツや産業機械設備などの重量のある商品まで、幅広い商品の梱包ニーズに応えます。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/padpak/padpak_guardian/index.html



次世代緩衝材システム
「PadPak Guardian®」

・高速すき間埋めシステム : FillPak® Mini

「FillPak® Mini」は、コンパクト・簡単操作・高い汎用性を兼ね備えたすき間埋めソリューションです。省スペース設計により、梱包テーブルが狭い、あるいはスペースに制限のある梱包現場にも設置が可能です。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/fillpak/fillpak_mini/index.html



高速すき間埋めシステム
「FillPak® Mini」

・高速すき間埋めシステム : FillPak® TTC

「FillPak® TTC」は、配送箱と製品とのすき間を高速で埋め、輸送中の揺れや衝撃を抑えます。ランダムに発生するさまざまなすき間を紙の柔軟性で容易に埋めることが可能です。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

<https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/fillpak/index.html>



高速すき間埋めシステム
「FillPak® TTC」

・ラッピングシステム : Geami MV™

「Geami MV™」は、コンパクトな電動タイプのラッピングコンバーターです。ハニカム状に広がる独自のダイカット紙が優れた表面保護性能を発揮し、各梱包テーブルへの設置が可能なため、梱包作業の効率化と省スペース化を同時に実現します。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/geami_w_rappak/geami_mv/index.html



ラッピングシステム
「Geami MV™」

・店内用梱包ソリューション : Geami Wrap 'n Go™

「Geami Wrap 'n Go™」は、小売店向けの省スペースな手動タイプのラッピングコンバーターです。ダイカット入りクラフト紙を3Dハニカム構造に展開して商品を保護し、テープやはさみ不要で迅速な梱包を実現します。テーブルトップやウォールマウントなど、店内環境に合わせた設置が可能です。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/geami_wrap_pak/geami_wrap_n_go/index.html



店内用梱包ソリューション
「Geami Wrap 'n Go™」

・自律走行搬送ロボット (AMR) : PUDU T300

「PUDU T300」は、製造現場や倉庫の設備・ニーズに応じ特別設計した産業用自律走行搬送ロボットです。複数の動作モードと豊富なアタッチメントで、さまざまな産業現場のニーズに柔軟に対応します。牽引モードでは最大400kgの重量物運搬が可能で、積載モードでは最大300kgまで搭載できます。製造業や物流センターでの作業効率を劇的に向上させ、24時間稼働による人件費削減と安全性向上を同時に実現可能です。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/hansou-robot/products/pudu_t300/index.html



© Pudu Technology Inc.

自律走行搬送ロボット (AMR)
「PUDU T300」

・業務用自律走行清掃ロボット（AMR）：PUDU CC1

「PUDU CC1」は、スイープ、バキューム、モップ、スクラブの4機能を1台に集約した業務用自律走行清掃ロボットです。

乾式・湿式の両方に対応し、多様な床材を効率的かつ高品質に清掃します。AIによる高精度な自律走行に加え、自動充電・自動給排水機能を備え、清掃業務の省人化と運用効率向上を実現。商業施設、物流施設、工場、オフィスビルなど幅広い現場で活用いただけます。



©Pudu Technology Inc.

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/cleaning-robot/pudu_cc1/index.html

業務用自律走行清掃ロボット
(AMR)

「PUDU T300」および「PUDU CC1」の名称、ロゴはPudu Technology Inc.社の登録商標です。

■株式会社PALTEKについて

PALTEKは、1982年の創業以来40年以上にわたり、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェア等の設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。2021年6月より、東証プライム上場の株式会社レスターのグループ企業となり、グループの幅広い商材・技術・ネットワークと連携することで、より包括的なソリューション提供が可能となっています。PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

PALTEKに関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1：ニュースリリースに関するお問い合わせ

会社名	株式会社 PALTEK
担当者	広報担当 柴崎・寺田
メールアドレス	pr@paltek.co.jp
所在地	〒108-0075 東京都港区港南二丁目 10 番 9 号レスタービルディング
電話	03-5479-7032

2：本展示会に関するお問い合わせ

会社名	株式会社 PALTEK
担当者	「国際物流総合展 2026」展示会担当者
メールアドレス	info_pal@paltek.co.jp
所在地	〒108-0075 東京都港区港南二丁目 10 番 9 号レスタービルディング
電話	03-5479-7020